

CORFIL® 658

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CORFIL 658 is a one-part epoxy material designed for use in insert or edge filling of honeycomb structure. The low viscosity of CORFIL 658 makes it especially suitable for automated or hand filling of small cell sized honeycomb. The thixotropic nature of CORFIL 658 ensures that there is no slump or resin separation during cure. CORFIL 658 is shipped frozen in sealed metal pails or plastic tubes packed with dry ice or by refrigerated carrier.

FEATURES & BENEFITS

Excellent spreadability and extrudability

Compatible with most 350°F (177°C) curing epoxy prepregs

Good compressive strength

SUGGESTED APPLICATIONS

Filling of honeycomb core in sandwich structures, especially in co-bond or co-cure applications

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность на сжатие	
	Тиксотропный	
Используется	Клеи	
	Заполнение приложений	
	·	
	Детали конструкции	
Внешний вид	Белый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Экструзия	
	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.650 to 0.750	g/cm³
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие (24°C)	44.8	MPa
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.0	%

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533



Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

